

证券代码：002957

证券简称：科瑞技术

公告编号：2026-007



深圳科瑞技术股份有限公司

2025 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 419,831,824 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	科瑞技术	股票代码	002957
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称（如有）	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李日萌	康岚	
办公地址	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A 塔 20 层	深圳市光明区玉塘街道田寮社区光侨路科瑞智造产业园瑞明大厦 A 塔 20 层	
传真	0755-26710012	0755-26710012	
电话	0755-26710011-1688；0755-26710007-1688	0755-26710011-1688；0755-26710007-1688	
电子信箱	bod@colibri.com.cn	bod@colibri.com.cn	

### 2、报告期主要业务或产品简介

#### （一）公司主营业务与经营模式

公司自 2001 年成立以来，深耕非标自动化技术应用、高精密零部件制造，是跨行业的非标自动化设备及解决方案领先供应商，产品主要包括自动化检测设备和自动化装配设备、自动化设备配件、高精密度零部件，产品广泛应用于移动终端、新能源、半导体及光模块、硬盘、汽车智驾、医疗健康等行业及领域。在行业竞争不断加剧的大环境下，公司致力于非标自动化技术的迭代与创新应用和高精度零部件的配套生产，公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平，与各行业领先品牌企业均建立了良好与稳定的业务合作关系，受到了客户广泛的认可和信赖，也获得了持续的业务机会。报告期，公司在保持三大战略业务稳定发展的基础上，积极开拓国内外半导体及光模块行业客户业务机会，进一步拓宽了公司的产品品类，抓住新兴行业应用的增长机会。

公司主要从事工业自动化设备的研发、设计、生产、销售和技术服务，以及精密零部件制造业务，产品具有定制化的特征，因此，公司采用直销的销售模式，和各行业品牌客户直接建立业务合作关系，在国内外非标自动化应用领域具备良好的品牌口碑。凭借在非标自动化领域二十五年的跨行业应用，公司具备深厚的研发设计能力，持续积累了机器视觉与光学、精密传感与测试、运动控制与机器人、软件技术、精密机械设计五大领域的相关技术，形成了高速自动化、精密测控、数字智能互联三大共性技术平台，以及与下游行业各类产品相关的专用核心技术平台，能够满足多种复杂自动化系统集成的技术要求。基于此，公司作为非标自动化设备供应商能够快速将客户需求转化为定制化的设备方案与产品，且能够快速进入有非标自动化设备需求的新兴增长行业。在一些领先行业，公司通常在客户新产品的研发设计阶段便配合参与其装配工艺与检测方案的预研，通过与客户紧密协作，深入分析客户产品的生产工艺、技术参数及质量管控要点等因素，确定自动化设备的功能架构、结构设计及方案。设备样机完成后，由客户进行产线验证，期间公司持续跟进调试与优化，确保设备与客户产品设计、工艺流程实现精准匹配，最终满足批量化生产需求。

## （二）报告期公司主要产品应用及其行业地位

在自动化行业深耕 25 年的发展历程中，科瑞技术始终聚焦各行业头部客户的自动化设备核心需求，凭借持续的技术研发与实践打磨，逐步形成了“高精、高速、高效、高智”四大鲜明技术特色，构建起坚实的技术壁垒与丰富的行业经验。其中，在移动终端业务领域，公司定位于整机及模组装配、检测设备领先供应商，为客户提供从单机到整线的定制化设备解决方案；在新能源业务领域，公司定位于新能源锂电制造设备行业中后段解决方案提供商，为客户提供高速、高效、高智设备定制解决方案；在精密零部件业务上，公司定位于中高端精密零部件及夹治具解决方案提供商，为客户提供高精度、超高精度零部件及夹治具定制解决方案；在半导体及光模块领域，公司以“高精度”为核心能力，匹配行业严苛的精度、稳定性需求，深耕半导体及光器件相关的高精密自动化组装与测试领域，为行业客户提供全流程、定制化的自动化设备解决方案。总体而言，公司在研发技术实力、快速交付能力、售后服务等方面均处于行业领先水平，与国内外各行业领先或知名品牌客户保持长期合作，受到了客户广泛的认可和信赖，也获得了持续的业务机会。具体行业应用情况如下：

在移动终端领域，公司定位于整机及模组装配、检测设备领先供应商，主要服务于全球领先的移动终端品牌及其相关产业链客户，建立了长期稳定的合作伙伴关系。公司产品及服务包括模组与整机装配和测试设备，聚焦移动通讯终端（手机）、智能穿戴终端及计算机终端（PC）三大核心领域，为客户提供包括整机摄像头及传感器测试、摄像头模组自动测试、IMU 标定、AR/VR 光学显示测试、AR/VR 摄像头与传感器综合标定测试设备、气密性检测设备、摄像头组装设备，TP 贴片设备，折弯老化测试设备，高速点胶设备，高精度贴装设备等多品类的自动化产品。在摄像头、显示屏、传感器三大核心测试领域，公司自主研发的光学测试算法、光学校准算法、AOI 检测算法、自动标定算法、自动化测试线智能调度软件系统能力，可提供高精度、高稳定、高效率的一站式自动化测试解决方案，拥有行业内最为完整的检测方案，是移动终端行业检测设备领先供应商。其中，公司自主研发的光学测试算法、光学校准算法、AOI 检测算法、自动标定算法、自动化测试线智能调度软件技术代表着行业领先水平，广泛应用于国内外行业领先品牌客户。针对 XR 产品检测，公司自研全套硬件及软件算法，可实现 XR/VR 全关键参数指标测试，可为客户提供光学显示模组（如光波导模组、PANCAKE 模组等）以及终端成品的性能测试，成功应用于各种 AR 技术路线如 BB、阵列波导、衍射波导、全息波导等产品，目前已批量为头部客户出货。行业首创整线测试方案，取代单机测试工站，进一步节省操作人力，减少测试误差，降低检测及产品升级成本，综合提高测试效率。并凭借深厚的行业理解，多元的技术能力，在研发端与客户深度合作，如与客户联合开发的 3C 类产品通用零部件装配平台，有效地扩大了行业通用度，提升了产线的标准化程度；公司与国内外多家头部客户保持长期紧密的合作关系，作为各头部客户的核心供应商，共同成长，携手推动移动终端行业的高速发展。

在新能源领域，公司定位于新能源电芯制造中后段解决方案提供商，公司深耕新能源行业 18 年，拥有数十项核心专利，聚焦行业头部客户的需求，是裸电芯制作（叠片设备）、化成分容设备、电芯包绝缘膜的领先供应商。公司凭借丰富的设备研发、制造与交付经验，深度联动锂电头部客户持续开展技术共创，并同步搭建完善的全流程质量管理与标准化售后交付系统，共同引领行业技术发展。

公司叠片设备核心技术优势显著，集成震动抑制、张力控制、尺寸闭环控制等多项自主研发专利技术，有效解决大尺寸电芯叠片、高精制程中的核心痛点，保障叠片精度与生产稳定性；公司设备兼容性极强，可适配幅宽 40~1200mm、片宽 40~300mm 的全规格电芯，充分满足不同客户的多样化产线需求。公司已实现 Z 型叠片、多片叠、热复合一体叠片机等全系工艺平台，深度布局消费电芯（3C）、动力电芯（EV）、储能电芯（ESS）三大领域，并基于全域工艺能力构建行业领先的制造体系，覆盖行业轻量化、高倍率、长循环等核心需求，打造全场景解决方案，为头部客户规模化扩产提供坚实装备支撑。

包绝缘膜（包蓝膜）也是锂离子电池制造的关键工序，是确保电池安全性和性能稳定的重要环节，直接影响电池的使用寿命、安全性和一致性。公司的包绝缘膜设备，以标准化设计、模块化架构为核心，依托公司成熟的规模化、标准化的生产制造体系，实现产品的持续迭代与性能优化，设备运行良率高、投产达产速度快，工艺适配性强，已成为行业内高优率、快达产的标杆产品。

化成分容工序作为锂电池制造过程中的核心工序之一，直接影响电池的电化学性能、循环寿命和使用安全，公司的化成分容设备兼具高效率与高稳定性，全面应用刀片、方形、圆柱、软包、蓝牙等全类型二次充放电电池，产品系列齐全，可适配不同工艺场景的化成分容需求。在一体机、高压直流母线等核心技术领域，公司实现行业首创并持续保持技术领先，并拥有成熟稳定的串联化成产品系列。针对固态/半固态电池的化成分容系统，也已顺利落地多个中试线、量产线项目，并稳定运行。热压化成设备也凭借领先的精度和稳定性，实现了大批量的交付，充分得到了市场的验证。公司还积极推动高效节能电源技术以及创新性结构设计，持续优化设备能耗和产线运行能耗，有效的提高设备充放电效率，同时通过紧凑化设计，减少产线布局占地面积，并通过模块化结构设计提高现场安装调试效率。持续的产品创新设计、优质的产品质量和高效的售后服务，从前期投入、场地成本、后期运维多维度帮助客户降本增效，获得国内外客户的一致认可与持续好评。

在半导体及光模块设备领域，公司定位半导体及光器件相关的高精密自动化组装与测试设备提供商，聚焦超高精度制造核心技术，自主研发并规模化交付超高精度设备。公司核心竞争力源于四大关键技术的持续突破与深度融合，各项技术相互支撑、协同发力，确保设备在精度、效率、稳定性上达到行业领先水平。公司高精度贴装及堆叠装配设备，最高精度可达 50nm；共晶设备精度突破 1 $\mu$ m、光耦合设备精度达 50nm，达到行业领先水平，技术产业化成果突出，在光模块领域提供多个核心工序的工艺设备并获得海外头部客户验证和认可。公司精准对接半导体及光模块行业不同应用场景的需求，先后推出一系列贴合市场、性能卓越的重点产品，覆盖光器件、芯片、光模块、晶圆等多个核心领域，具体产品包括：光器件耦合设备：适配光器件组装核心需求，实现高精度耦合，保障光器件传输性能稳定；镜片、镜群耦合设备：针对镜片、镜群的组装场景，提供高精度耦合解决方案，提升光学组件的装配精度与效率；光模块芯片 AOI & COS AOI 检测设备：依托自主研发的视觉算法，并结合 AI 相关算法，实现芯片及 COS 缺陷的快速、精准检测，助力提升芯片产品合格率，同时 COS AOI 之后还可对接精确分类及包装，实现 COS 产品从 AOI 检测，分选及包装的整线交付；光模块芯片共晶贴片设备：适配光模块芯片贴装需求，实现高精度、高稳定性贴装，保障光模块性能；超高精度堆叠设备：针对高精密器件堆叠场景，实现超高精度控制，满足半导体及光模块行业小型化、高密度的发展需求；IGBT/Sic 晶圆焊片芯片及辅料贴装整线设备：适配 IGBT、Sic 功率器件的贴装需求，保障器件封装的精度与可靠性，完成自动化整线的交付，助力功率半导体领域发展；光纤打磨设备，通过粗磨、精磨等步骤，将光纤端面加工成特定的物理结构，确保光纤能够精准物理对接实现人工替代，提升效率并保障产品良率和一致性。公司凭借领先的技术实力、可靠的产品质量与优质的服务水平，已成功与半导体及光模块行业多家龙头企业建立深度合作关系，核心客户涵盖国内外知名企业，包括多家国内行业标杆企业以及海外光器件品牌企业。这些合作不仅彰显了公司在半导体及光模块领域的行业地位与核心竞争力，更通过标杆项目的落地实践，进一步优化产品与服务，积累了更多贴合行业需求的经验，为后续市场拓展奠定了坚实基础。

在精密零部件领域，公司产品主要包括精密零部件、模具、夹治具以及模组装配。产品主要应用于对精度要求比较高的自动化设备或作为机械零部件直接对外销售。公司拥有高精度、超高精度精密零部件加工高端设备 500+ 台套，具备各种材料、各工序精密零部件制造加工能力，拥有车、铣、平磨、内外圆磨、镗磨、光学磨、CNC、电火花、线切割以及模具、夹具装配等全工序高精度加工能力，在线切割、电火花、镗磨、平面磨、光学磨等工种的加工精度可达到  $\pm 1\mu$

m 以内。下游客户涵盖领域广泛，长期服务半导体、消费电子、新能源、计量仪器、医疗、LED、硬盘等领域的国内外品牌客户，产品精度、质量及服务广受认可及好评，有较强的竞争力以及稳健的盈利能力。

公司持续同步深耕其他先进制造业的制造领域，为各战略新兴行业提供一体化定制化智造解决方案。在新能源汽车和智能驾驶、医疗、智能工厂及物流、硬盘等领域作为核心供应商为国内外头部客户提供核心工艺或整厂自动化解决方案。在新能源汽车和智能驾驶领域：为国内外多家头部客户提供电驱、电控、电子电气、智能驾驶零部件及核心模组的自动化组装和检测设备，覆盖新能源汽车核心零部件智造全链条。

公司凭借核心技术优势，落地覆盖高端制造关键赛道，成为移动终端、新能源、半导体及光模块、硬盘存储、汽车智驾、医疗健康等行业及领域的核心供应商，为国内外头部客户提供核心工艺自动化及整厂级智能制造解决方案及高精度零部件。此外，公司依托成熟的质量管理体系与全球化交付能力，顺利完成美国、泰国、越南、沙特等海外市场订单的高品质交付，实现核心技术与高端装备的全球化输出。

### （三）业绩驱动因素

#### 1、行业因素

公司定位跨行业的非标自动化设备和精密零部件应用，非标定制设备需要投入前期研发、样机验证、工艺调试及定制化零部件采购的需求，具有单项目成本高、周期长的商业模式特征，公司业绩主要与客户产品销量、功能改变与升级换代、产业链制造环节的布局或调整有关。因此公司精准选择终端市场规模巨大、需求增长迅速且对装配效率、精度、检测工艺要求高的下游领域，从而形成规模化订单回报，公司作为国内首批自动化设备公司之一，深度陪伴了各行业国内外品牌客户对非标自动化设备需求增长的每一轮机会。2000年初，PC普及与存储技术升级带动硬盘行业崛起，亚微米级精密装配设备需求持续释放，公司依托行业机遇，以硬盘业务为起点稳步发展；2008年至2018年的移动终端消费电子黄金十年，公司深度参与了国内外智能手机品牌爆发式增长过程中巨量自动化装配、检测设备的需求供给，尤其国际品牌客户对其产品品质和使用体验的要求，充分带动公司检测设备的持续需求；2019-2023年，新能源电池行业高速发展，新能源车渗透率持续攀升，带动行业产能需求集中爆发。凭借多年技术沉淀，公司自研的锂电叠片制芯设备、各类锂电装配设备及化成分容设备，成为行业扩产核心刚需装备，深度服务多家新能源头部企业。2024年起，AI算力基础设施建设成为核心增长引擎，光模块加速向800G、1.6T甚至3.2T迭代，推动高精度耦合、高精度贴装、高速测试、光纤打磨等非标自动化产线需求迎来爆发式增长。同时，基于国家战略的半导体国产化需求，尤其是在存储芯片（HBM、DDR5）和先进封装领域，国内厂商扩产意愿强烈且国产化率仍有较大提升空间，为非标设备公司打开了长期增长通道。

#### 2、政策因素

近年来，非标自动化设备行业的下游赛道爆发，往往与国家战略导向和政策资金支持深度绑定。2024年以来，围绕半导体国产化、AI算力基建和新质生产力培育，中央与地方密集出台了一系列产业政策，为设备公司创造了确定性的需求窗口。政策明确指向光模块代际升级和AI服务器产业链扩张，直接拉动了对高速光模块自动化组装线、精密耦合设备、高速测试设备等非标自动化装备的需求。同时，政策引导下的国产化替代趋势，也为国内设备商创造了从0到1的进入机会。

2025年8月，工业和信息化部等七部门印发的《推动工业领域设备更新实施方案》提出推动工业领域大规模设备更新，有利于扩大有效投资，有利于推动先进产能比重持续提升，对加快建设现代化产业体系具有重要意义，到2027年工业领域设备投资规模较2023年增长25%以上。2025年9月工信部等六部门联合发布的《机械行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，推动优质装备企业上市融资、落实工业母机等企业税收优惠政策，强调发展智能装备和系统，推动人工智能与装备融合创新。2026年政府工作报告明确提出“深化拓展‘人工智能+’，实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。2026年1月，工信部等八部门联合印发《“人工智能+制造”专项行动实施意见》，明确支持突破高端训练芯片、人工智能服务器、高速互联等关键核心技术，有序推进高水平智算设施布局。地方政府层面，深圳市工信局于2026年3月发布《深圳市加快推进人工智能服务器产业链高质量发展行动计划（2026—2028年）》，明确提出推动光模块从800G向1.6T/3.2T代际升级，支持800G及以上光模块量产项目落地，重点发展高速率、低功耗硅光模块及CPO/LPO/NPO封装光模块，并提出到2028年AI服务器全产业链产能与出货量实现跨越式增长的目标。这些政策直接拉动了对高速光模块自动化组装线、精密耦合设备、高速测试设备、光纤研磨设备等非标自动化装备的采购需求。总体而

言，从中央专项到大基金、从地方补贴到行业稳增长政策，多层次的顶层设计与地方落地政策形成共振，为设备公司创造了确定性的扩产驱动力和国产化替代的历史性机遇。

### 3、公司自身能力积累

公司始终专注于自动化技术在先进制造领域的跨行业应用。公司自 2001 年为硬盘行业客户提供精密自动化装配与检测设备以来，伴随着中国制造发展和下游客户的自动化需求，2007 年进入新能源锂电业务，2008 年进入智能手机整机检测业务，2015 年开始为电子烟、汽车、医疗、食品与物流等多个行业领先品牌客户提供自动化设备与相关服务，2024 年开始为国内外半导体和光模块行业品牌客户提供服务。公司能够在各个关键行业周期起点与各行业领先或知名品牌客户达成合作，得益于公司深厚的技术积累与持续研发投入、深度客户绑定与合作开发能力、快速交付与卓越制造能力、非标自动化技术跨行业技术复用能力、全球本地化售后服务能力、前瞻性产能布局储备，各方面口碑受到国内外行业客户的认可，获得了持续的业务机会。

综上所述，下游行业发展、产品创新、客户的产品和制造工艺升级，宏观政策方向和产业政策支持、公司的自动化技术能力、供应链与交付能力，公司与各行业领先客户的合作关系和能力共同构成了公司业绩的驱动因素，正是这种“选对赛道、提前卡位、绑定核心客户”的能力，构成了公司业绩驱动要素，公司业绩有望在新一轮的行业轮动周期中获得较高增长。

## 3、主要会计数据和财务指标

### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	6,347,886,236.05	5,473,664,067.71	15.97%	5,903,347,984.48
归属于上市公司股东的净资产	3,234,337,364.61	2,906,693,810.39	11.27%	2,868,149,493.22
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	2,632,473,986.32	2,447,701,287.30	7.55%	2,857,358,910.91
归属于上市公司股东的净利润	273,084,227.65	139,375,713.45	95.93%	173,589,206.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,720,798.48	124,174,572.91	38.29%	109,820,304.25
经营活动产生的现金流量净额	482,017,514.06	288,633,544.01	67.00%	311,558,607.40
基本每股收益（元/股）	0.6541	0.3396	92.61%	0.4220
稀释每股收益（元/股）	0.6540	0.3396	92.58%	0.4220
加权平均净资产收益率	8.87%	4.84%	4.03%	6.15%

### (2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	535,788,217.12	570,637,491.16	654,765,125.97	871,283,152.07
归属于上市公司股东的净利润	44,254,272.04	78,688,424.62	123,931,884.13	26,209,646.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	45,030,955.16	74,069,165.36	37,419,171.89	15,201,506.07
经营活动产生的现金流量净额	289,954,862.45	81,191,540.98	85,362,025.38	25,509,085.25

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 否

#### 4、股本及股东情况

##### (1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	32,404	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	35,164	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
COLIBRI TECHNOLOGIES PTE LTD	境外法人	35.89%	150,749,231	0	不适用	0	
深圳市华苗投资有限公司	境内非国有法人	13.89%	58,338,415	0	不适用	0	
青岛鹰诺投资有限公司	境内非国有法人	6.96%	29,225,268	0	不适用	0	
兴业银行股份有限公司—华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.56%	6,572,400	0	不适用	0	
GOLDEN SEEDS VENTURE (S) PTE. LTD.	境外法人	1.04%	4,384,941	0	不适用	0	
中国工商银行股份有限公司—诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	2,945,700	0	不适用	0	
国泰海通证券股份有限公司—天弘中证机器人交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.65%	2,745,755	0	不适用	0	
中国银行股份有限公司—华安文	其他	0.56%	2,349,400	0	不适用	0	

体健康主题灵活配置混合型证券投资基金						
香港中央结算有限公司	境外法人	0.52%	2,201,802	0	不适用	0
深圳科瑞技术股份有限公司—2025 年员工持股计划	其他	0.38%	1,616,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东无关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东深圳市华苗投资有限公司通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,000,000 股，通过普通证券账户持有 55,338,415 股，实际合计持有 58,338,415 股。					

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

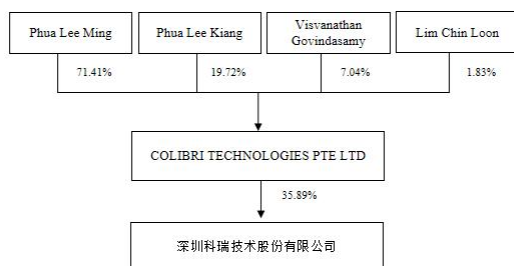
适用 不适用

## （2）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用 不适用

## 三、重要事项

### （一）公司发展战略

在三大主营业务方面，移动终端业务坚持针对 AR/VR、模组及整机测试技术、摄像头模组装配段的组装技术及标定技术、3D 感知技术和空间计算的持续研发和投入，围绕核心测试技术深挖整机检测、模组检测、AR/VR、自动化解决方案等领域的市场需求，发挥技术积累和业务经验，深挖国内品牌客户需求，拓展国内业务。公司将继续深耕泛消费电子

（含 AI 硬件、AR/VR/MR）领域，持续强化核心测试技术与产品平台，巩固头部客户合作基础，同时积极拓展新市场，助力客户实现高质量增长，致力于成为泛消费电子领域最具影响力与客户信赖度的自动化测试解决方案提供商，推动行业技术升级，成为全球智能硬件自动化测试领域的领导者。

新能源业务将延续战略定位，在超高速叠片技术、高速电芯包绝缘膜技术等产品持续迭代。聚焦于制芯、化成分容设备和电芯包绝缘膜等细分市场，增强业务竞争力以提升市占率与业务增长。加强推进海外市场开拓，强化交付质量，同时，推行稳健的经营策略，聚焦在利润率较高、竞争力更强的产品线上，改善经营结果。

在精密零部件业务上，公司将紧抓行业机会，加大资源投入，并持续拓展超高精度零部件加工业务，为客户提供高精密、高质量、高可靠性的智能设备精密零部件产品。

在 N 类业务领域，公司服务海内外头部客户，覆盖半导体及光模块、硬盘存储、汽车智能驾驶、医疗健康等重点行业，深度绑定核心客户，重点推进半导体和光模块相关业务，光伏行业的智慧物流搬运，智能仓储及调度系统的进一步研发和重点客户的业务拓展。同时将关注具身智能和工业级 3D 打印等新兴市场需求，进行技术储备，为未来持续的业绩增长提供研发支持。为应对不确定的国际局势，公司也将稳健提升海外市场的业务功能和占比，承接国际品牌客户的海外产能需求。同时持续优化并整合 N 类培育型业务，聚焦至有明确发展机会的行业或产品。

在质量与交付方面，公司将持续打造卓越制造能力，将品质安全与信息安全作为战略基石。质量意识筑牢根基，数据安全意识赢得信任，运营精细化管理能力保障效率与成本优势，三者相互支撑，共同构成公司在非标自动化设备领域持续为客户创造价值的核心竞争力。通过“卓越制造”与“信息安全”双轮驱动，按时、按质交付满足客户定制化需求的设备与零部件，同时秉持对客户知识产权的最高尊重与保护，构建起深层次的信任壁垒和长期合作粘性。

在投资方面，公司将延续自我发展和投资并行的战略，积极寻找能够与公司实现产业协同、技术补充的优质资源，提升公司市场竞争力，形成业务+投资双轮驱动的生态化发展模式。同时，公司也将全面管控风险，保障投后项目的保值、增值与双向赋能。

在技术研发方面，公司将持续推进超高精度技术在产品上的应用，重点投入资源推动半导体、光模块相关工艺技术突破，并整体规划 AI 在产品、技术、运营管理等方面的应用，提升公司整体竞争力。

在供应链与资源配置方面，公司将持续追求降本增效，进一步加强与战略供应商的深度合作，推行标准化成本管理；加强供应链情报搜集，提升采购专业能力和海外覆盖能力。

在组织管理方面，公司将加快推进管理团队年轻化的目标。基于公司各业务单元发展阶段的不同，制定差异化薪酬体系。强化结果导向的薪酬激励政策以提升公司领导队伍工作的积极性。

为提高公司决策质量，降低决策风险，公司也将进一步提升董事会及专业委员会在公司管理中的参与程度，发挥独立董事和专业委员会在公司治理上的重要作用，在公司战略规划与业务方向、人力资源政策、技术研发路径等重大事项决策中，提供专业意见。同时全面加强与合作方的沟通交流，广泛吸纳各方的意见与建议。

## （二）报告期经营计划完成情况

2025 年公司围绕 3+N 业务战略开展经营活动，公司积极采取提质增效举措，经营结果符合预期。移动终端行业公司积极应对组建海外生产基地满足客户海外产能需求，并在国际客户的自动测试线以及国内领先客户的自动化业务、摄像头及光学模组检测业务拓展取得阶段性成果；新能源行业领域锂电产业链投资扩产势头回暖，公司聚焦新能源行业头部客户订单获取、积极拓展海外业务，并通过积极管控物料成本、生产成本和应收账款催收管理等措施，主动控制经营风险；精密零部件业务加快超高精度领域能力建设，布局华东、华南区域产能扩张空间及固定资产投资，经营规模持续扩大，报告期内，硬盘、半导体及光模块领域业务增长势头明确，并保持优质稳健的盈利能力。N 类业务经营稳定，持续拓展半导体及光模块设备业务，在光模块领域提供多个核心工序的工艺设备并获得海外头部客户验证和认可，并凭借多元化的技术研发体系，完善的供应链体系及严格的质量管控体系，支撑了国内头部客户高端产品大批量交付的需求，成为头部品牌客户的非标自动化核心供应商，业务进一步拓展，订单取得较大突破。

### （三）2026 年度经营计划

公司将持续优化商业模式设计，强化业务组合管理与成本管理，稳固三大主营业务占比份额与盈利能力的稳态，提升国内优质业务占比，同时将积极开拓海外业务，提高业务竞争力与可持续发展能力。移动终端领域，重点强化海外基地全链条能力建设，同时加大国内市场拓展力度，实现海外与国内业务协同增长。新能源领域，紧跟新能源电池技术发展趋势，集中资源争取大客户订单，巩固行业竞争优势。精密零部件领域，聚焦超高精度能力的深化应用，重点推进净化间加工与装配业务，全力承接国内大客户产能需求。N 类业务，积极拓展国内外新增客户及量产设备品类，包括但不限于共晶贴片设备、各类耦合设备、光纤打磨设备、AOI 芯片检测设备，并积极储备相关行业研发技术，综合提高公司整体业务组合的竞争力和可持续发展能力。同时加快完成产能布局，持续强化海外本地化运营能力，同步推进惠州、苏州、深圳、成都四大基地产能升级与扩建工程，为下一轮高速发展储备充足空间；优化海外资源配置与协调，强化越南、泰国本地化业务能力。

2026 年度公司总体经营目标为实现销售收入 29-33 亿元，以上目标不代表公司对 2026 年的盈利预测。全球经济形势、国家政策、行业政策、社会环境、市场需求变化等多方面因素都将对公司业务带来直接和间接的影响，请投资者特别注意。

### （四）可能面对的风险及应对措施

#### 1、经营环境不稳定的风险

国际政治经济环境多变，或将导致市场供需关系的不确定性以及经济的不稳定性，进而导致公司订单减少、盈利能力下降等风险。公司将密切关注经济环境的变化，妥善制定应对措施，同时布局跨领域业务，分散风险、提高抗风险能力。

#### 2、原材料价格波动的风险

全球经济环境变化及通货膨胀加剧，或将导致包括芯片在内的众多原材料价格波动、交付周期延长。原材料价格的上涨、交付周期的延长会对公司的生产成本产生直接的不利影响，有可能带来公司毛利率水平和利润水平降低的风险。

公司将密切关注原材料价格的波动，内部通过设计与采购、计划与项目管理协作，开展战略供应链管理并对关键原料器件进行管控，妥善制定应对措施。

### 3、国际业务的汇率波动风险

公司在出口产品、进口原材料时主要以美元结算。汇率波动将对当期利润带来一定的影响。如人民币出现短期内大幅升值，公司产品出口及经营业绩将受到不利影响。公司将积极关注汇率变动趋势，通过积极调整外汇策略并开展远期结售汇业务，尽可能规避汇兑损失风险。

### 4、应收账款发生坏账的风险

公司因业务结构发生变化，应收账款增幅较大，且应收账款周期延长。目前公司应收账款回款正常，但不排除如果发生重大不利影响因素或突发事件，可能发生因应收账款不能及时收回而形成坏账的风险，从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。公司将持续加强应收账款管理，建立多维度风险预警体系及应收管理办法，加强风险防范，降低应收账款发生坏账的风险。

### 5、下游应用行业发展节奏和规模不达预期的风险

非标自动化设备公司的下游应用领域广泛，各行业的发展节奏与规模扩张存在显著的不确定性，在以下方面存在收入规模风险：一是技术迭代不及预期，如固态电池、1.6T 光模块等新技术的产业化进程若推迟，将直接导致设备采购需求延后或减少；二是终端市场需求波动，如智能手机进入存量竞争、新能源车补贴退坡或储能项目并网不及预期，可能引发下游客户缩减资本开支、推迟或取消扩产计划；三是产能阶段性过剩，部分行业在快速扩张后可能出现结构性产能过剩，导致新设备订单骤降，存量产线升级需求也随之放缓；四是政策与外部环境变化，半导体国产化进程受地缘政治影响存在不确定性，AI 算力基建的行业热度、财政支持力度也可能波动。上述风险一旦发生，将导致已投入的研发成本无法回收、在手订单延期或取消、应收账款周转恶化，进而对业绩产生较大冲击。